

臺灣桃園地方法院民事判決

111年度重訴字第64號

原告 詮豐科技股份有限公司

法定代理人 楊德發

訴訟代理人 倪映驊律師

被告 千邑企業股份有限公司

法定代理人 童士豪

訴訟代理人 廖克明律師

複代理人 曾雍博律師

上列當事人間請求損害賠償事件，於民國115年1月7日辯論終結，本院判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

(一)伊為自民國106年即成立之專業印刷電路板PCB代工廠商，與被告有多年委託代工之往來，被告為一次銅之加工承包商，代工品質尚稱穩定，兩造有於106年簽署代工合約書及品質合約書(下稱系爭品質合約書)，被告本應依約對伊負品質保證之責任。而伊於110年3月5日起陸續接獲訴外人瀚宇博德股份有限公司(下稱瀚宇博德公司)之承攬訂單，委託伊承製如附表一所示4張訂單共1萬9612片之型號0000000-0之印刷電路板(下稱系爭電路板)。伊於確認訂單後，即自110年3月起陸續發包各加工製程分批製作，系爭電路板之加工順序為壓合、鑽孔再經電漿除膠渣製程後，至被告公司代工「除膠渣」、「一次銅電鍍」之製程代工，批次日期如附表一所示(2117指西元2021年度第17週批次製造)，經被告公司加工

01 後，再經後續各站加工檢測合格後，第一批(批次日期代碼2
02 117)出貨至瀚宇博德公司為110年4月24日，110年5月再出貨
03 1批批次日期代碼同為2117之系爭電路板，之後5、6、7月再
04 出貨數批，批次日期代碼為2118之系爭電路板；瀚宇博德公
05 司陸續於110年6月出貨至終端客戶。

06 (二)於瀚宇博德公司110年8月9日突以電子郵件反應終端客戶表
07 示系爭電路板發生不良反應，並指明系爭電路板經過溫度衝
08 擊(Thermal shock)試驗時，發現有電路通電不良微斷無法
09 通電之現象，並懷疑是「一次銅電鍍」不良所造成，請伊查
10 明回覆，伊也因而立即取回不良產品，請認證之印刷電路板
11 認證分析單位，並就各加工公司及材質單位分別進行各種測
12 試與分析，最終統合各單位意見，均指向被告公司製程中
13 「除膠渣」不良，導致孔壁膠渣咬蝕不良及孔銅與內層銅環
14 形裂開之異常，進而導致電路通電不良，顯屬可歸責於被告
15 之瑕疵，而因系爭電路板所有加工流程均為無可回復之程
16 序，加工完成即無法修補與事後檢測，故被告應負相關損害
17 賠償責任。

18 (三)因被告製程不良導致伊交付客戶之系爭電路板遭客戶退貨共
19 4835片，另有PCBA已上件之印刷電路板共542片，且因系爭
20 電路板發生嚴重瑕疵，瀚宇博德公司也不願收受其他這段期
21 間由伊製作之電路板，最後一批日期代碼2130共有1萬2000
22 片遭瀚宇博德公司拒收並取消訂單。統計共有如附表二之所
23 失利益新臺幣(下同)715萬8380元，及客戶扣款之所受損失2
24 24萬8016元；另伊亦以起訴狀之送達作為解除契約之意思表
25 示，故亦無給付代工服務費用之義務，因此被告所受領伊所
26 給付之12萬4146元即屬無法律上原因，應予返還。

27 (四)瀚宇博德公司反應之瑕疵為業界所謂「電路微斷」，需要大
28 量電流通過才有辦法檢測出來，本件經財團法人工業技術研
29 究院(下稱工研院)鑑定後可知確實有電鍍層剝離之瑕疵，可
30 認為被告之加工程序有瑕疵無訛；被告身為承攬人，如主張
31 有其他免責事由即應自負舉證責任，是被告主張係因板材浸

01 泡溫度與時間有誤，或係因「除膠渣」製程僅有1次而非2次
02 所造成瑕疵，即屬被告舉證之範圍。

03 (五)爰依兩造簽訂之系爭代工合約書、系爭品質合約書以及民法
04 第494條、第495條、第179條規定提起本訴，並聲明：(一)
05 被告應給付原告953萬542元，及自起訴狀繕本送達翌日起至
06 清償日止按週年利率5%計算之利息。(二)願供擔保請准宣
07 告假執行。

08 二、被告則以：

09 (一)原告原先係主張因伊「製程之『除膠渣』不良，導致孔壁膠
10 渣咬蝕不良及孔銅與內層鍍環形裂開之異常，進而導致電路
11 通電不良」，但本件經工研院之鑑定結果並未提及造成該現
12 象之具體原因，也表示無法確認殘留物是膠渣，故其鑑定報
13 告自無從認定係伊製程有何瑕疵。又系爭電路板之製程眾
14 多，亦不能排除鑑定報告所指之情形為其他製程所造成。故
15 原告實際並未證明伊有製程上之工作瑕疵存在。

16 (二)系爭電路板為台燿公司「TU872-LK」電路板，依照台燿公司
17 官網對於電路板之介紹，並有製作指引手冊，依照指引手冊
18 可知系爭電路板於鑽孔製程後必須經過2小時、攝氏180度之
19 烘烤(bake)，以釋放壓力及增加上銅品質，但依照原告提供
20 給伊之生產製造流程單(下稱系爭生產製造流程單)，完全沒
21 有鑽孔後烘烤之製程，足見原告提出之系爭生產製造流程單
22 與台燿公司指引手冊相違，原告並未依照標準程序製作流
23 程，則鑑定報告所示「通孔中段存在鍍銅與銅箔內層分離現
24 象」亦不能證明係伊工作有瑕疵。況且，伊所負責之「除膠
25 渣」製程為化學除膠渣，其目的僅在讓孔壁更為光滑，即便
26 鑑定報告所顯示之殘留物為膠渣，因在伊負責之「一次銅電
27 鍍」、「除膠渣」製程之前尚有鑽孔程序及電漿除膠渣程
28 序，且欠缺必要之鑽孔後烘烤程序，則原告稱係因伊製程造
29 成瑕疵，亦難認可採。

30 (三)再者，兩造除簽訂系爭品質合約書以外，另於109年12月24
31 日簽訂報價單，有約定「PTH及一次銅專業代工」之約款第6

01 點「如因客戶疏失以致流程工單…據上規定條件錯誤造成產
02 品報廢，本公司將不負擔任何賠償責任」，既然原告提供之
03 系爭生產製造流程單欠缺鑽孔後之烘烤程序，應屬上述客戶
04 疏失情形，故伊亦無庸負擔任何損害賠償責任。既然本件並
05 不存在民法第494條、第495條之瑕疵，原告依此主張解除契
06 約即屬無據。

07 (四)另原告主張有遭退貨部分並未見原告提出證據說明，況退貨
08 之1萬2000片電路板是否存在瑕疵、是否係因伊所造成，均
09 未見原告說明，原告僅稱是業界慣例，並稱為所失利益，而
10 請求伊負損害賠償責任，應無理由。況伊對於原告至少有20
11 4萬6698元之承攬報酬債權(另經伊對原告提起訴訟，即鈞院
12 111年度建字第50號)，縱認伊須負損害賠償責任，亦主張抵
13 銷抗辯。

14 三、原告主張被告承攬系爭電路板之「一次銅電鍍」製程不良造
15 成瑕疵，因而主張解除契約，並請求損害賠償，以及請求被
16 告返還已收受之代工費，惟為被告所否認，並以前揭情詞置
17 辯，是本件應審究者為：(一)系爭電路板是否因被告承攬之
18 「一次銅電鍍」製程不良發生瑕疵？(二)原告主張解除兩造
19 就系爭電路板之承攬契約，並請求返還已交付之代工費12萬
20 4146元，有無理由？(三)原告請求被告負損害賠償責任，即
21 請求給付如附表二編號1、2所示損失總價，有無理由？(四)
22 如被告須返還已受領之代工費並負損害賠償責任，被告主張
23 就對於原告之204萬6698元之承攬報酬債權為抵銷抗辯，有
24 無理由？經查：

25 (一)本件無從認定系爭電路板瑕疵係因被告「一次銅電鍍」製程
26 不良所造成。

27 1.按工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補
28 之。承攬人不於前條第1項所定期限內修補瑕疵，或依前條
29 第3項之規定拒絕修補或其瑕疵不能修補者，定作人得解除
30 契約或請求減少報酬。但瑕疵非重要，或所承攬之工作為建
31 築物或其他土地上之工作物者，定作人不得解除契約。因可

01 歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵者，定作人除依前二
02 條之規定，請求修補或解除契約，或請求減少報酬外，並得
03 請求損害賠償。民法第493條第1項、第494條、第495條第1
04 項分別定有明文。次按當事人主張有利於己之事實者，就其
05 事實有舉證之責任。民事訴訟法第277條本文定有明文。則
06 原告主張被告之工作有瑕疵，進而主張相關權利，即應由原告
07 先就被告工作瑕疵負舉證之責。

08 2.原告主張其所製作之系爭電路板，係將10T095FM009A00料號
09 物品進行層層加工所製作，並有於110年4月12日、110年5月
10 4日、110年5月5日將10T095FM009A00料號物品，交由被告承
11 攬「一次銅電鍍」、「除膠渣」之製程等情(見本院卷三第4
12 0頁)，經原告提出製造生產流程單(下稱系爭製造生產流程
13 單)、兩造110年4至5月代工對帳單等件影本附卷可稽(見本
14 院卷一第189、55至57頁)，為被告所不爭執(見本院卷三第4
15 0至41頁)，此情首堪認定。

16 3.而原告客戶瀚宇博德公司於如附表一所示下單日期向原告下
17 單如附表一所示訂單數量之系爭電路板，原告因而將被告等
18 廠商就10T095FM009A00料號物品加工完成之製品即系爭電路
19 板出貨予瀚宇博德公司，惟經瀚宇博德公司於110年8月9日
20 以電子郵件向原告反應有PTH deamination之情形乙節，則
21 有瀚宇博德公司訂單4份、瀚宇博德公司110年8月9日電子郵
22 件等件影本附卷為憑(見本院卷一第25至39頁)，上情亦堪認
23 定。

24 4.原告主張系爭電路板之瑕疵係因被告「一次銅電鍍」製程不
25 良所造成等情，經查：

26 (1)本件有將系爭電路板送工研院進行鑑定，且鑑定機關及兩造
27 於取樣時因系爭電路板無法透過電性分析挑選異常樣品，故
28 現場合意由兩造各自選定鑑定標的1之4處位置及鑑定標的2
29 之4處位置，合計共16處位置由鑑定機關進行結構分析，鑑
30 定機關再抽樣擇定鑑定標的1之U15、U21以及鑑定標的2之U1
31 7及U21以光學顯微鏡及掃描式電子顯微鏡對其進行微結構分

01 析，並依「IPC-A600 Acceptability of printed boards」
02 驗收標準(下稱IPC-A-600標準)，進一步判斷鑑定標的是否
03 存有IPC-A-600標準中描述之不符合標準(不合格)情況，鑑
04 定結論為鑑定標的1之位置U21，發現通孔(Plated Through
05 Hole，下稱PTH)之中段存在鍍銅與銅箔內層分離現象，此現
06 象為IPC-A-600標準描述的不符合標準情況；而鑑定標的2之
07 位置U21，則發現PTH中存在異常厚度之鍍層結瘤，其屬IPC-
08 A-600標準中描述之不符合標準情況，有工研院114年1月23
09 日印刷電路板微結構鑑定分析報告(下稱系爭鑑定報告)在卷
10 可參(見本院卷二第387至411頁)。是依照系爭鑑定報告，確
11 實有「PTH中段存在鍍銅與銅箔內層分離現象」、「PTH存在
12 異常厚度之鍍層結瘤」之不符合標準之瑕疵情形。

13 (2)然依照原告公司就系爭電路板提供給各加工廠商之系爭製造
14 生產流程單(見本院卷一第189頁)，系爭電路板之生產流程
15 中須經包含原告、被告共13個廠商、23個製程，系爭鑑定報
16 告固然指出系爭電路板確實存有瑕疵，但並無從逕認係何製
17 程造成此瑕疵。又原告聲請鑑定時也希望能鑑定係何製程造
18 成瑕疵(見本院卷二第252頁)，故本院原本依原告聲請送工
19 研院鑑定之事項包含「查明是否有電路通電不良之瑕疵？如
20 有瑕疵，可能造成瑕疵之原因及製程為何？」，工研院原先
21 與其現行研發領域不盡相同，故婉辭鑑定囑託，但原告表示
22 係因送錯單位，希望再送一次鑑定，但工研院於取樣時即告
23 知需將上開鑑定事項調整改為微結構鑑定分析，原告亦無意
24 見乙節，有本院112年4月11日桃院增民慧111重訴64字第112
25 0010788號函(稿)二、(三)、工研院112年7月26日工研轉字
26 第1120016346號函、本院112年8月11日電話查詢紀錄表、本
27 院112年8月15日桃院增民慧111重訴64字第11290103172號函
28 (稿)三、(三)、工研院113年1月29日工研轉字第1130001835
29 號函、原告113年2月21日民事陳述意見三狀附卷可憑(見本
30 院卷二第299、307、319、327、351、359頁)；足認工研院
31 於鑑定時已表示僅能進行微結構鑑定分析，而不能就可能造

01 成瑕疵之原因及製程進行鑑定，益證系爭鑑定報告確實無從
02 認定是系爭電路板何項製程造成瑕疵。

03 5.原告固然主張依照系爭鑑定報告可知為電鍍製程之問題，且
04 瀚宇博德公司當時有進行電測，但發生電路微斷導致無法通
05 電，鑑定後也確認確實有「PTH中段存在鍍銅與銅箔內層分
06 離現象」、「PTH存在異常厚度之鍍層結瘤」之瑕疵，故應
07 為被告負責之「一次銅電鍍」製程發生問題等語。經查：

08 (1)瀚宇博德公司於110年8月9日寄送電子郵件向原告表示「客
09 戶反應料號PCB-00-000000-00/0000000-0，在經過thermal
10 shock發現有PTH deamination。速查找並回覆原因分析」，
11 並有檢附照片，有瀚宇博德公司110年8月9日電子郵件等件
12 影本附卷為憑(見本院卷一第33至39頁)；參照上開電子郵件
13 中檢附之照片與系爭鑑定報告「PTH中段存在鍍銅與銅箔內
14 層分離現象」之照片相似(見本院卷二第395頁)，但瀚宇博
15 德公司亦僅表示希望原告找出原因，顯然並未確定係何製程
16 發生問題。

17 (2)惟原告表示於瀚宇博德公司反應後除了與被告公司積極聯繫
18 如何處理外，也有將系爭電路板、零件板、切片送交相關廠
19 商及品質保證分析單位進行分析，而認為應係被告承攬製程
20 造成鍍銅不良原因等語。然查，依照原告提出之電子郵件
21 中，宜特科技公司有於110年8月31日回信表示「由於膠渣的
22 殘留有可能不是一個單純的個體，若是照您懷疑的狀況(槽
23 液汙染反沾)，所表現出的成分分析可能就會更複雜了。因
24 此將如我們今日討論，針對異常品與純基材進行元素分析比
25 較與提供結果給貴司，再請您確認稍後業務所提供的分析報
26 價。如同意施作，請隨時通知我替您安排實驗排程，謝
27 謝」，又於110年9月3日回信表示「1. SEM profile看起來凸
28 起疑似反沾回去的物質，與基材不連續。2. EDX中發現許多
29 兩塊基材中沒有的物質(Mg/S/Zn/Ba)，這之中僅有Mg元素也
30 有在CEM-3基材中發現」，有宜特科技公司電子郵件附卷可
31 憑(見本院卷二第159至167頁)，但並沒有明確指出係何原因

01 所造成；原告亦當庭表示依照宜特科技公司之電子郵件確實
02 無法直接看出來是被告造成的瑕疵，故請求送工研院進行鑑
03 定，並希望請鑑定機關找出可能發生電路板瑕疵之製程為何
04 (見本院卷二第252頁)，堪認上述宜特科技公司電子郵件亦
05 無從認定係被告公司負責之製程造成瑕疵。是原告起訴時所
06 提出之瀚宇博德公司、宜特科技公司之電子郵件，確實不足
07 以證明係因被告公司製程造成瑕疵。

08 (3)又參以原告起訴時係主張「原告立即將不良產品取回，分別
09 請認證之印刷電路板認證分析單位，並就各加工公司及材質
10 單位分別進行各種測試與分析，最終統合各單位之意見，均
11 指向被告公司之製程中除膠渣不良，導致孔壁膠渣咬蝕不良
12 及孔銅與內層銅環形裂開之異常，進而導致電路通電不
13 良」，有民事起訴狀貳、一、(三)附卷可參(見本院卷一第5
14 頁)，可知原告起訴時係主張被告所承攬之「除膠渣」過程
15 發生不當產生瑕疵。故系爭鑑定報告完成後，被告尚有請求
16 補充鑑定系爭鑑定報告之鑑定標的1之位置U21之照片是否可
17 確認為「膠渣」，經工研院回覆系爭鑑定報告所附電子顯微
18 鏡影像僅能呈現物質之結構與形貌特徵，無法單憑該影像判
19 斷殘留物成分是否為膠渣乙節，則有本院114年7月23日桃院
20 雲民慧111重訴64字第1140081000號函(稿)、工研院114年8
21 月8日工研轉字第114005278號函附卷可憑(見本院卷二第46
22 5、471頁)。

23 (4)是故，原告起訴時即自承所提出之瀚宇博德公司、宜特科技
24 公司之電子郵件並無法確認係何製程造成瑕疵，而系爭鑑定
25 報告同樣未能證明是系爭電路板的哪項製程造成瑕疵，已如
26 前述；原告更是從主張被告負責之「除膠渣」製程不當，改
27 為主張「一次銅電鍍」製程不當，卻同樣是以瀚宇博德公司
28 電子郵件、系爭鑑定報告為據，故原告一再聲稱系爭鑑定報
29 告佐以瀚宇博德公司電子郵件可知被告負責之「一次銅電
30 鍍」製程確實有所不當，並無所據，而無從採信。

31 6.再者，原告固稱其為定作人，依實務見解只須證明工作有瑕

01 疵即可，如被告主張有其他免責事由即應自負舉證責任云
02 云。經查：

03 (1)按定作人主張工作有瑕疵，請求承攬人負瑕疵擔保責任者，
04 僅須舉證證明工作有瑕疵之事實，無庸證明承攬人有可歸責
05 之事由；承攬人如抗辯工作之瑕疵，係因定作人所供給材料
06 之性質而生者，對此項免責之事由，應負舉證責任(最高法
07 院105年度台上字第1257號民事判決意旨參照)。依上開實務
08 見解可知，定作人係需證明「工作有瑕疵」，然本件原告固
09 已證明系爭電路板有瑕疵，但並未證明係何項加工製程(即
10 工作)有瑕疵存在；而系爭電路板生產流程中須經包含原
11 告、被告共13個廠商、23個製程，業如前述，並有系爭製造
12 生產流程單附卷可參(見本院卷一第189頁)，既然原告認為
13 僅需證明系爭電路板有瑕疵存在，即可對承攬人求償，為何
14 只向被告請求賠償？堪認原告本需證明如何特定是在被告負
15 責的「一次銅電鍍」、「除膠渣」製程發生瑕疵，始能依前
16 開規定對被告求償。

17 (2)本件原告提出之證據資料及系爭鑑定報告均不足認係被告負
18 責之「一次銅電鍍」製程造成瑕疵，已如前述。而「電鍍」
19 顧名思義即係在原物料上鍍上保護料，如原物料本身即有凹
20 凸、截斷之情形存在，電鍍也不能因而治癒原本即存在之凹
21 凸、截斷之狀態；故系爭鑑定報告固然確認系爭電路板有
22 「PTH中段存在鍍銅與銅箔內層分離現象」、「PTH存在異常
23 厚度之鍍層結瘤」之瑕疵存在，但究係在被告取得物料之前
24 即存在凹凸、截斷情形，或是因被告「一次銅電鍍」製程之
25 不完善所造成，應仍屬原告釐清證明之範圍。

26 (3)況被告更表示依照電路板採購及微切片手冊內容可知，鑽孔
27 時鑽針與板材強力摩擦所產生的溫度甚高，又因玻纖樹脂與
28 碳化鎢均為不良導體，故所累積的熱量常使得孔壁瞬間溫度
29 高達200°C以上，如此一來不免使得部分樹脂被軟化而成為
30 膠糊，隨著鑽針的旋轉而塗滿孔壁，各內層孔環的側銅面也
31 自不能倖免，冷卻後變成膠渣(Smear)，形成後來孔環與銅

01 壁在“互連”面的障礙，這就是名氣很大業內人盡皆知
02 由“Smear”所造成的“Separation”，並提出99年電路板
03 採購及微切片手冊節本附卷為證(見本院卷二第459至461
04 頁)；依照系爭製造生產流程單所示(見本院卷一第189頁)，
05 「一次銅電鍍」製程之前有昶律興公司負責之Plasma(電漿
06 除膠渣)以及被告負責之「除膠渣」，如果前述兩種除膠渣
07 製程之工作未完全，造成物料表面不平整，則系爭電路板出
08 現「PTH中段存在鍍銅與銅箔內層分離現象」、「PTH存在異
09 常厚度之鍍層結瘤」，又豈能認定確屬被告負責之「一次銅
10 電鍍」製程出現瑕疵？

11 (4)從而，原告根本未證明被告之「一次銅電鍍」工作有瑕疵，
12 其稱應由被告應就其餘免責事由負舉證責任，容有誤會。

13 7.綜上，原告並未證明系爭電路板係因被告負責之「一次銅電
14 鍍」製程不良而造成瑕疵。

15 (二)原告並未能證明被告負責之「一次銅電鍍」製程不良而造成
16 系爭電路板有瑕疵，業如前述，則原告自不得依民法第494
17 條規定解除契約，亦無從進而請求被告返還已收受之代工費
18 12萬4146元。更無從再依民法第495條規定請求被告負損害
19 賠償責任。

20 (三)按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各
21 得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。民法第334條第1項
22 本文定有明文。查原告主張被告應返還已受領之代工費及負
23 損害賠償責任，均無理由，業如前述，則被告並未對原告負
24 有債務，即無須就被告主張之抵銷抗辯有無理由，再為論
25 述，併予敘明。

26 四、綜上所述，原告依兩造簽訂之系爭代工合約書、系爭品質合
27 約書以及民法第494條、第495條、第179條規定，請求被告
28 給付共計953萬542元，為無理由，應予駁回。又原告之訴既
29 經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

30 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核
31 與判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

01 六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
02 中華民國 115 年 3 月 23 日
03 民事第四庭法官 丁俞尹

04 以上正本係照原本作成
05 如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。
06 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
07 中華民國 115 年 3 月 25 日

08 書記官 張禕行

09 附表一

編號	瀚宇博德公司 訂單號	客戶型號	被告料號 (如原證7)	下單 日期	原定交期	訂單數量 (片)	每片單價 (新臺幣)	訂單金額 (新臺幣)	批次日期代碼 (Day Code)
1	0000000000	000000-0	10T095FM009A00	3/5	3/10	102	365元	37,230元	2117
2	0000000000	同上	同上	3/5	3/10	510	365元	186,150元	2117
3	0000000000	同上	同上	3/22	4/27	1,000	365元	365,000元	2118
4	0000000000	同上	同上	3/30	5/2	6,000	365元	2,190,000元	2118
5	0000000000	同上	同上	5/4	待通知	12,000	365元	4,380,000元	2130
合計								7,158,380元	

11 附表二

編號	損害賠償原因	數量	單價 (新臺幣)	損失總價 (新臺幣)
1	品質不良全數退貨	19,612	365元	7,158,380元 (如附表一)
2	客訴零件賠償扣款	542PCBA零件板		2,248,016元
3	已付代工費	110年4至5月		124,146元
合計				9,530,542元

13 依民事訴訟書狀規則第 5 條規定：
14 當事人未依格式或記載方法製作書狀，經法院定期間通知其補
15 正，而未補正或未能補正符合規定之書狀者，法院得拒絕其書狀
16 之提出，不列為訴訟資料；其嗣後再就同一事由提出未依格式或
17 記載方法製作之書狀者，不生效力，法院毋庸處理。
18 當事人於前項期間內補正者，視同於原書狀到院時已提出；逾期
19 始提出符合規定之書狀者，為新提出之書狀。

01 當事人未依第一項規定補正前，法院得不將書狀分與法官辦理。